2027年3月期第2四半期
[2026年4月～2026年9月]

決算説明会

2026年11月11日(水)



TEKSCEND PHOTOMASK

INDEX

第一部：2027年3月期第2四半期　決算概要

取締役 執行役員 CFO　糸雅 誠一

第二部：市場環境アップデート

代表取締役 社長執行役員 CEO　二ノ宮 照雄

第一部：2027年3月期第2四半期　決算概要

財務ハイライトと分析 - 概況

	2027年3月期 第2四半期	
売上収益 成長率	**前年同期比 ＋19.7%**	• 半導体市場はAI・データセンター関連製品の需要が強く、微細化も進展 • 外販フォトマスク市場の成長： – 内作リソースは最先端ノードに集中、先端ノードにおける外部調達化が継続 – 半導体市場の需要に支えられ、ファウンドリ向けは前年対比で先端ノード中心に堅調に推移 ※USドルベースでは前年同期比11.4%(参考値) 増加
営業利益率	**24.6% 前年同期比 ＋2.4pt**	• 2027年3月期第2四半期の営業利益率は前年対比2.4ポイント増加 ⇒新規導入設備による固定費増を先端品受注増でのミックス改善により利益率改善
EBITDA マージン	**37.5% 前年同期比 ＋0.2pt**	• 2027年3月期第2四半期期のEBITDAマージン※1は前年対比0.2ポイント増加 ⇒先端品受注増でのミックス改善によりマージン改善
設備投資	**累計実績 227億円／通期計画 630億円**	• 成長ドライバーである先端ノード向け投資に注力 - シンガポールに製造拠点を新設 - US/韓国で先端向けラインを追加

注：
※1 EBITDA=親会社株主に帰属する当期利益＋法人所得税費用－金融収益+金融費用+減価償却費及び償却費。 EBITDAマージンはEBITDA÷売上収益で算出

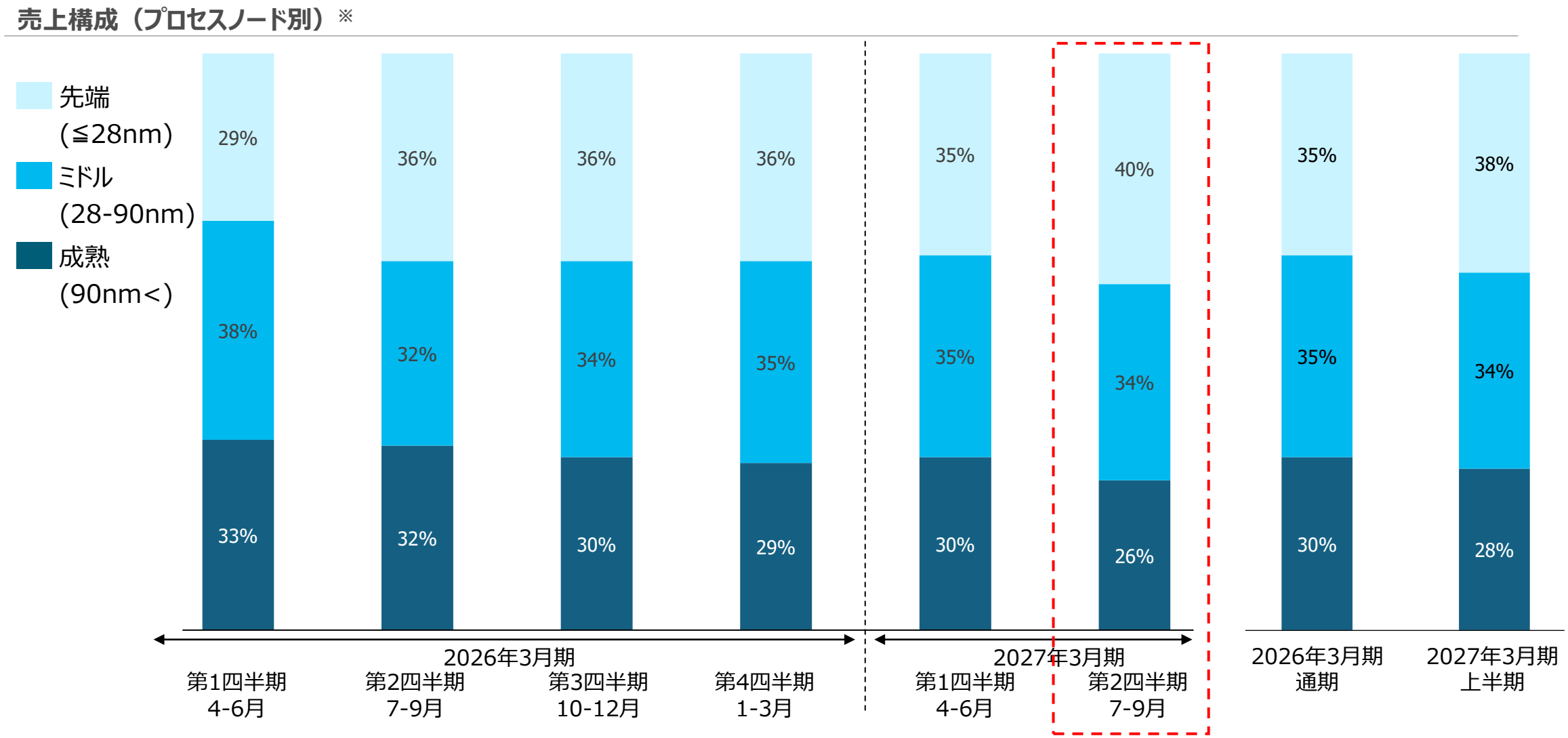
連結業績状況 - 2027年3月期第2四半期PL

- 売上収益：アジア中心に先端品の取り込みにより前年同期比・前四半期比ともに増収
- 営業利益：先端品受注増加によるミックス改善の効果で前年同期比・前四半期比ともに増益
- 当期利益：金融資産の時価評価の減少により前年同期比減益、法人税等の減により前四半期比増益

日本円（百万円）	2027年3月期 第1四半期	2027年3月期 第2四半期	2027年3月期 上半期	増減率 前年同期比 27/3 Q2 vs 26/3 Q2	増減率 前四半期比 27/3 Q2 vs 27/3 Q1	増減率 累計前年同期比 27/3 Q1-Q2 vs 26/3 Q1-Q2
売上収益	**34,518**	**37,944**	**72,462**	19.7%	9.9%	17.3%
売上総利益率	*33.2%*	*36.6%*	*35.0%*	1.6Pt	3.4Pt	1.1Pt
営業利益	**7,360**	**9,339**	**16,699**	33.0%	26.9%	29.5%
営業利益率	*21.3%*	*24.6%*	*23.0%*	2.4Pt	3.3Pt	2.1Pt
中間利益（四半期利益）	5,300	6,752	12,053	▲1.8%	27.4%	▲2.4%
親会社の所有者に帰属する中間利益（四半期利益）	**5,300**	**6,752**	**12,053**	▲1.8%	27.4%	▲2.4%
為替レート (USD/JPY)	160.72円	159.36円	160.04円			
参考値						
EBITDA （百万円）	12,228	14,231	26,460	20.4%	16.4%	20.3%
EBITDAマージン	***35.4%***	***37.5%***	***36.5%***	***0.2Pt***	***2.1Pt***	***0.9Pt***
売上収益 （千USD）	214,771	238,103	452,774	11.4%	10.9%	7.1%
営業利益 （千USD）	45,795	58,603	104,344	23.8%	28.0%	18.2%

売上構成 - プロセスノード別

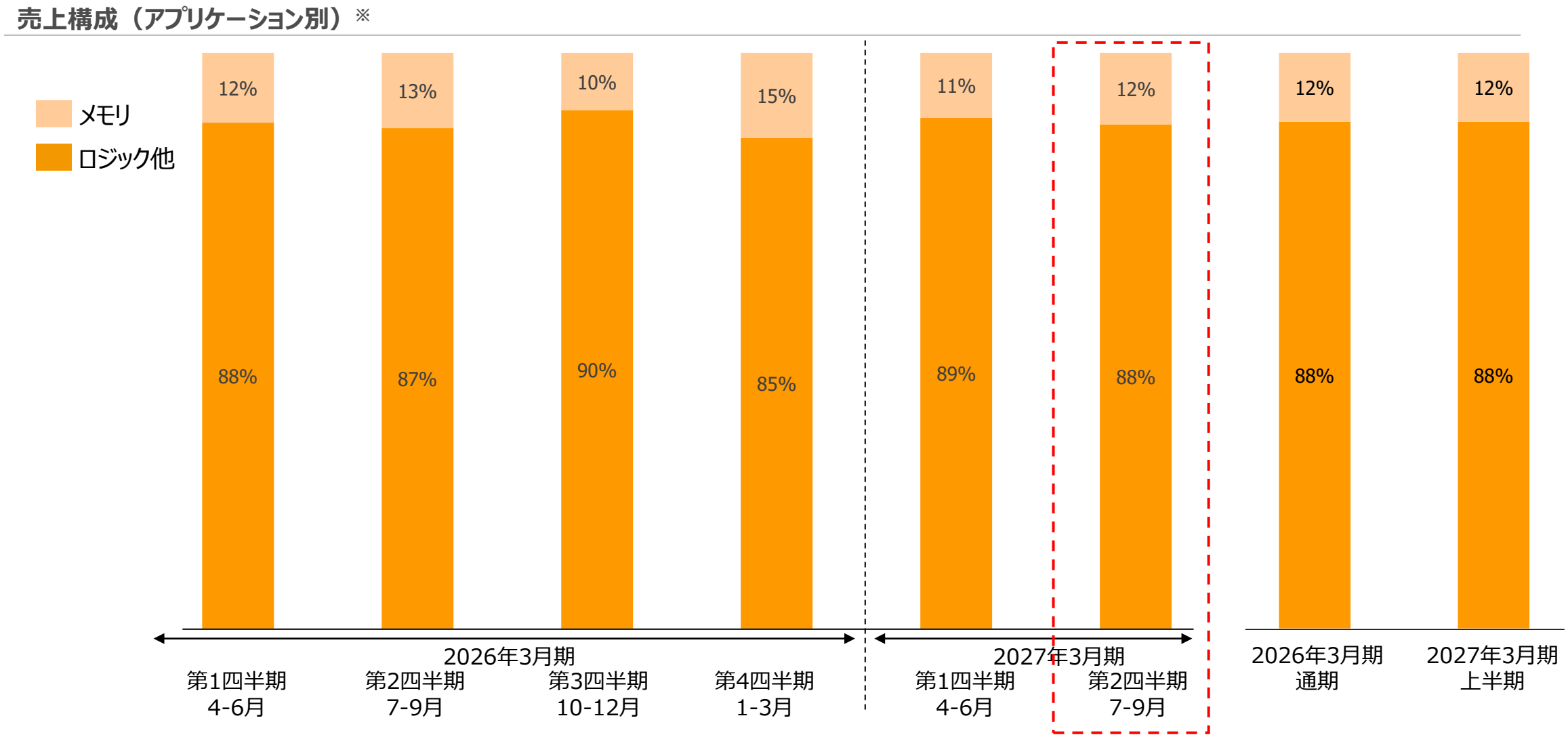
- 先端ロジック向け需要が引き続き堅調に推移し、先端ノード（≦28nm）の売上構成比は40%まで上昇



※ フォトマスク製品に関する売上のみで集計

売上構成 - アプリケーション別

- メモリ向け需要もAI関連投資を背景に底堅く推移しており、ロジック・メモリ双方が安定した需要環境を維持

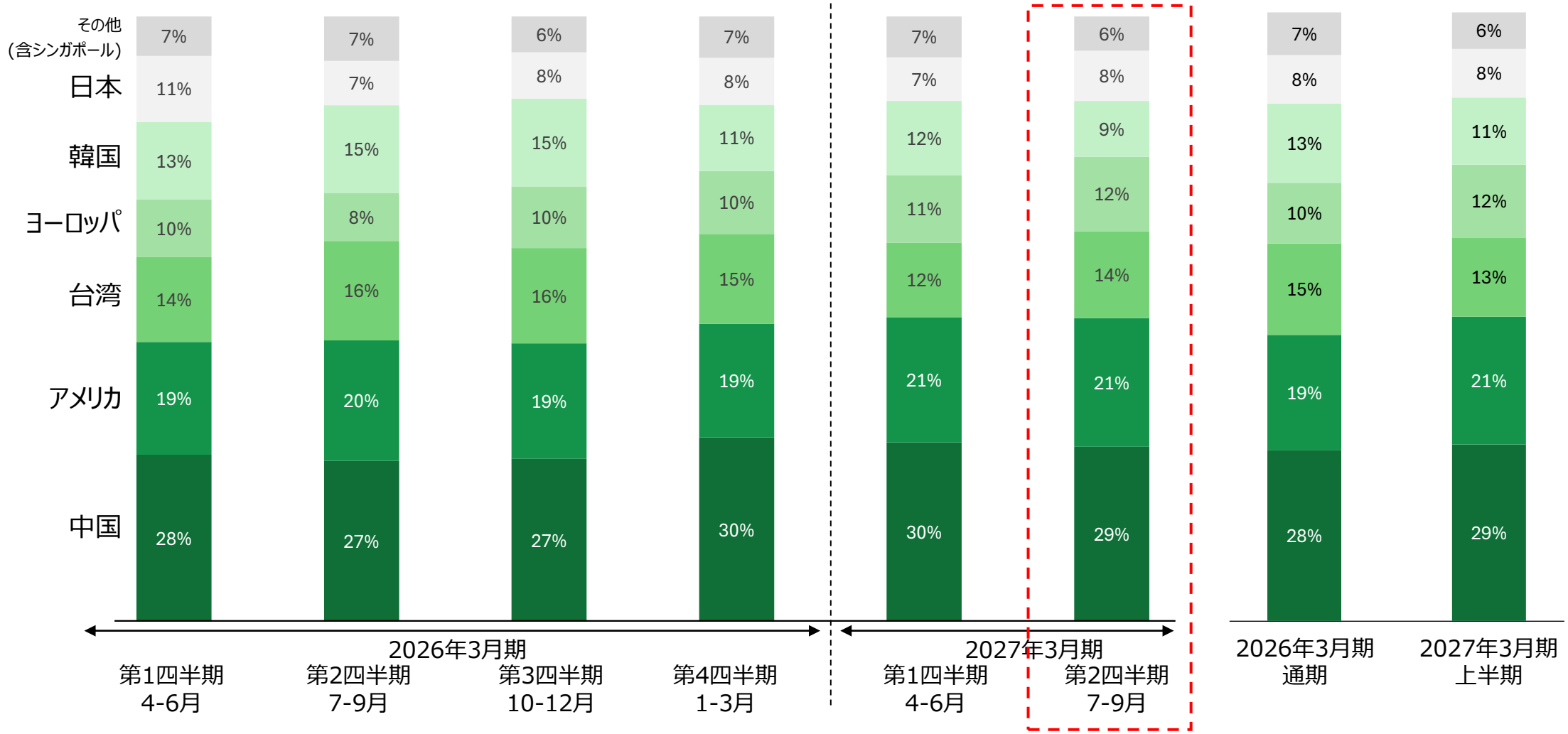


※ フォトマスク製品に関する売上のみで集計

売上構成 - 地域別（仕向け地）

- グローバルでの取引拡大が順調に進展。地域別売上構成の分散が進み、顧客ポートフォリオの多様化を実現
- 台湾向けは1Q期間のトラブル解消により比率向上。他の地域の先端需要も順調に取り込み、先端品比率の向上に貢献

売上構成（地域別）※



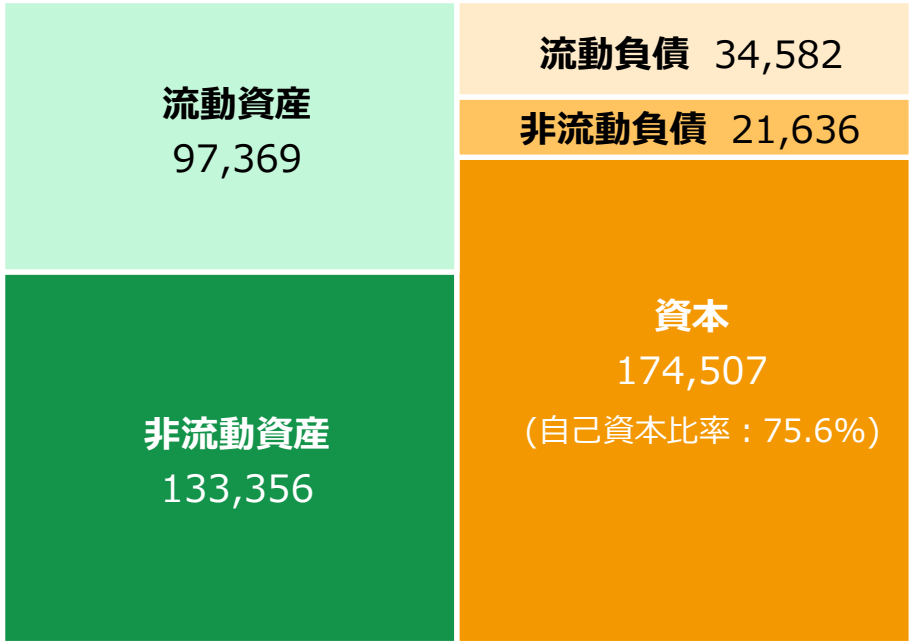
※ドルベースで算出

連結業績状況 - 2027年3月期第2四半期BS

- 総資産：現金及び現金同等物、有形固定資産の増加により、前連結会計年度末比で＋52,047百万円
- 負債　：工場新設・設備増強による資金需要に向け銀行借入を実施、前連結会計年度末比で＋48,263百万円
- 資本　：上半期の利益により堅調に増加、他方で、負債増加に伴い自己資本比率は63.1%となった

2026年3月末 資産・負債・資本

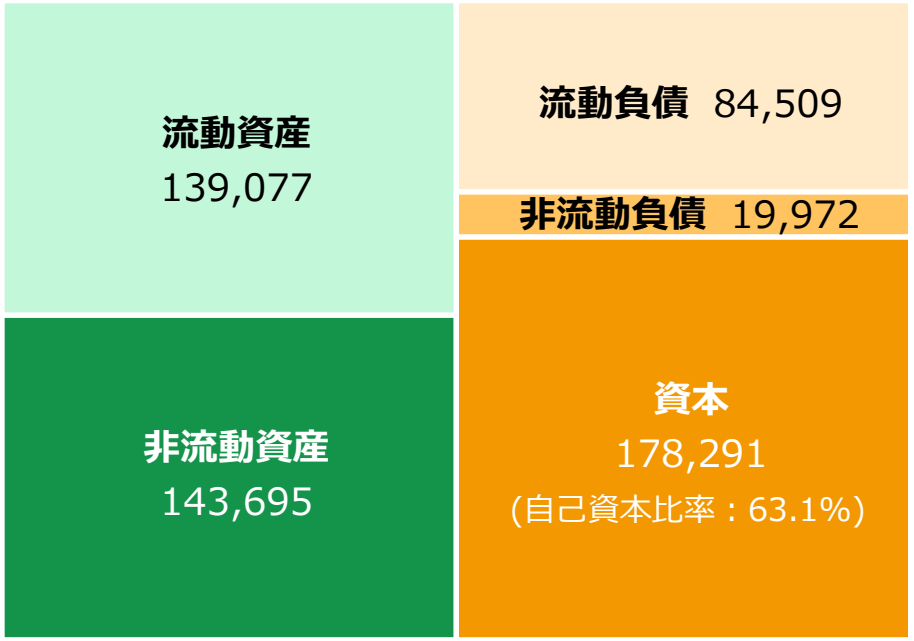
（単位：百万円）



総資産 230,725

2026年9月末 資産・負債・資本

（単位：百万円）



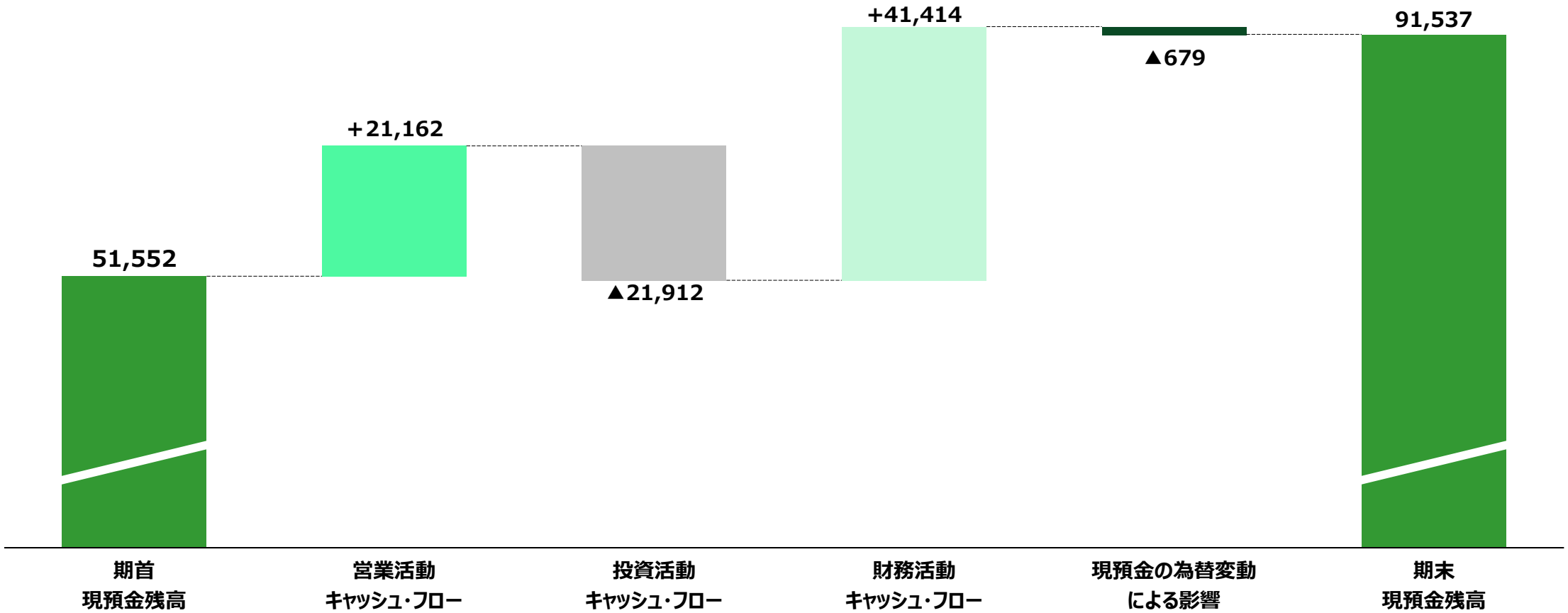
総資産 282,773

連結業績状況 - 2027年3月期第2四半期CF

- 営業CF：税引前利益16,884百万円、減価償却9,475百万円等により、＋21,162百万円
- 投資CF：有形固定資産の取得22,720百万円等により、▲21,912百万円
- 財務CF：短期借入による調達50,000百万円、26年3月期の配当金支払い5,556百万円等により、＋41,414百万円

2027年3月期第2四半期累計キャッシュ・フロー

（単位：百万円※）

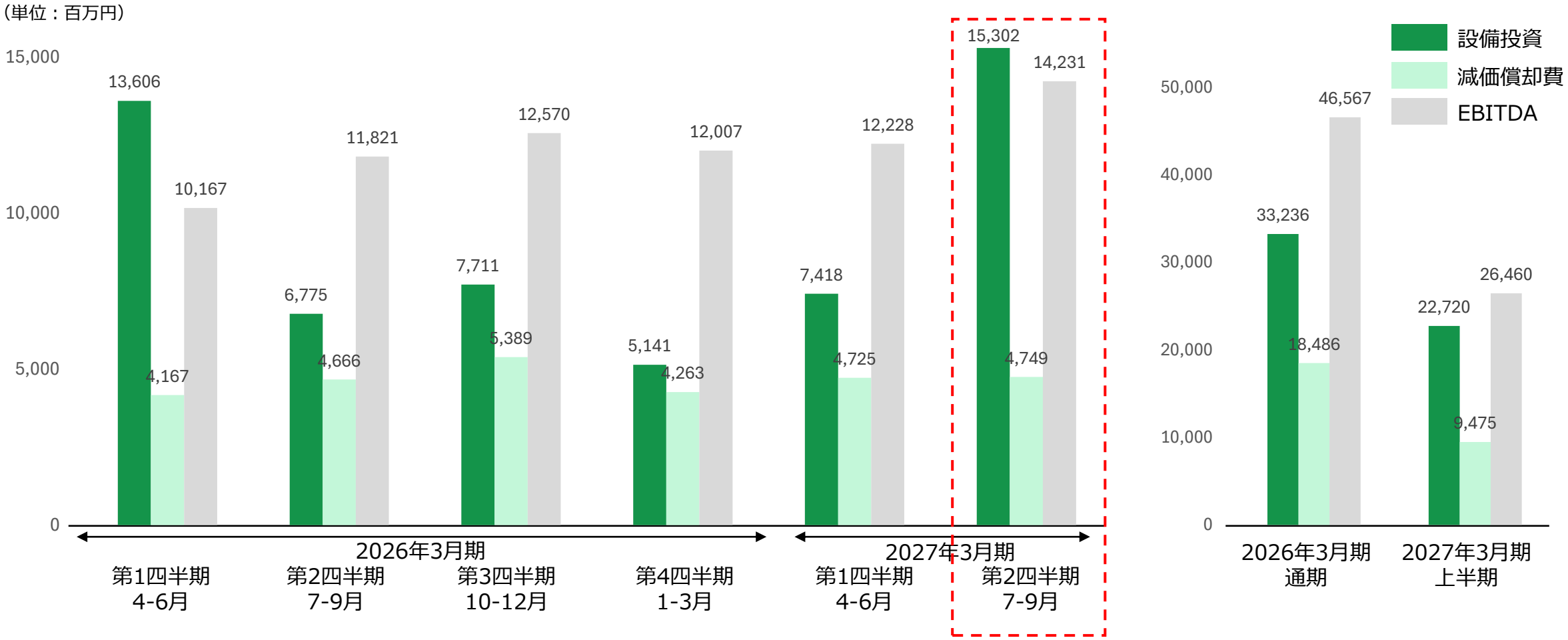


※百万円未満切り捨て

連結業績状況 - 設備投資 / 減価償却費 / EBITDA

- 成長投資の設備導入本格化により設備投資額がEBITDAを上回るが、今期は投資額が営業CFを大きく上回る予定のため借入れ等により柔軟な資金調達を実施

2026年3月期-2027年3月期



連結業績予想に対する進捗率

- 1Qの大手受注苦戦を2Qの先端品取込み及び費用削減により挽回し、通期の見通しに対してインラインで進捗

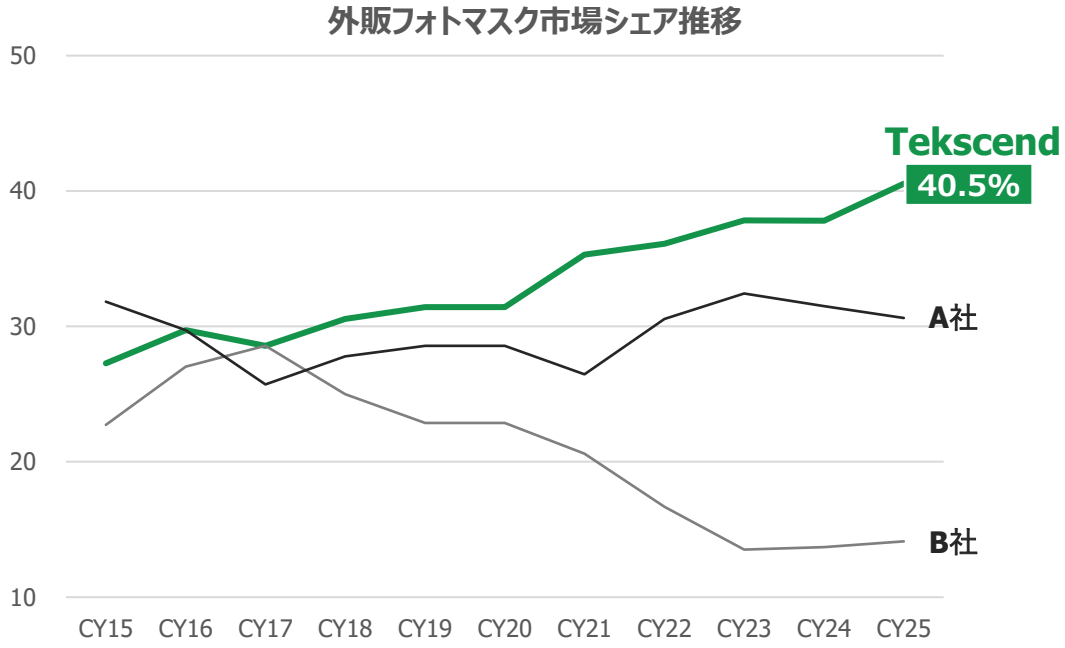
日本円（百万円）	2027年3月期 通期 見通し	2027年3月期 上半期 実績	進捗率
売上収益	140,100	72,462	51.7%
営業利益	29,800	16,699	56.0%
売上高営業利益率	21.3%	23.0%	
税引前利益	31,200	16,884	54.1%
売上高税引前利益率	22.3%	23.3%	
親会社の所有者に帰属する当期利益	23,700	12,053	50.9%
売上高利益率	16.9%	16.6%	
為替レート (USD/JPY)	145円 (想定)	160.04円	-

Topics

Topics

SEMI 外販フォトマスクシェア　2025年実績更新

- **2025年の外販フォトマスク市場:当社シェアNo.1**
  - SEMIが毎年公表している外販フォトマスク市場のシェアに関して2025年実績が8月に発表された。
  - 当社は40.5%で前年に対して+2.7%となり、前年に引き続きトップシェアを維持。
  - 2017年以降、当社は右肩上がりでシェア拡大を続けており、10年連続のトップでかつ初の40%超となった。



格付の取得

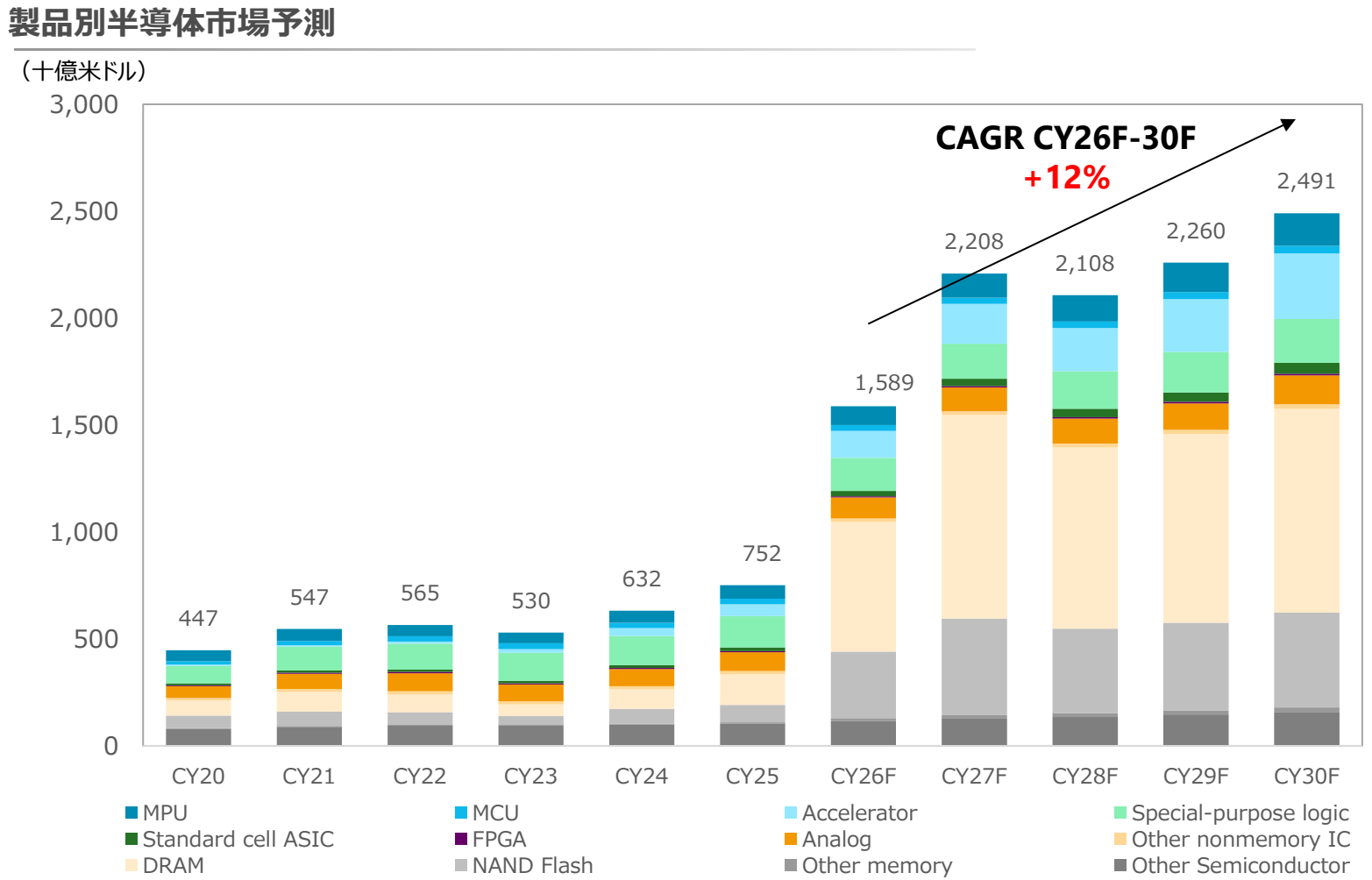
- **株式会社日本格付研究所（JCR）による長期発行体格付を取得（2026年10月30日公表）**
  - 経営の透明性と対外的な信用力を高めることを目的として第三者機関から客観的な評価を取得。当社の事業内容及び財務状況の健全性について高く評価された。

格付機関	格付対象	格付	格付の方向性
JCR	長期発行体格付	A	安定的

第二部：市場環境アップデート

市場環境（半導体）

- AI関連の需要とクラウドインフラへの投資を背景に、2026年に半導体業界はメモリ主導で1兆ドルの壁を早期に突破し、2027年には2兆ドルへと過去に例のない成長局面へ入る見通し
- 2028年は調整局面が想定されるものの、その後は年率12%程度の高成長を維持

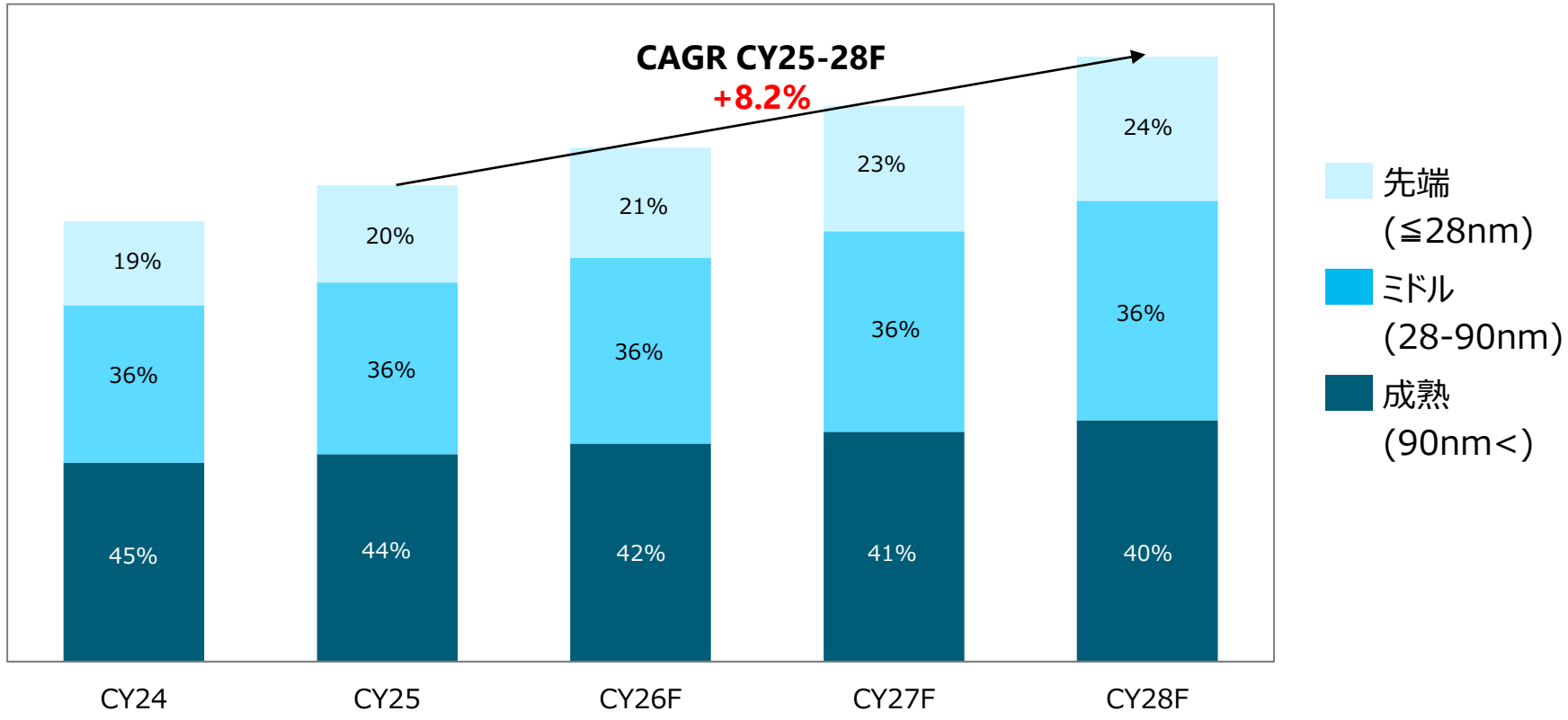


出典： IBS Oct 2026

市場環境（デザイン数の拡大）

- 計算性能や省電力性能への要求が高まる中、先端ノードを活用した半導体の新規設計需要が増加している
- AI技術の活用拡大によりEDA（電子設計自動化）や設計プロセスの生産性向上が進展し、開発期間の短縮とコスト削減を背景に設計需要が拡大している
- 市場規模・案件数は成熟ノード向けの設計が依然として最も多いものの、先端ノード向けの設計が高い成長率となっている

デザイン数（外販フォトマスク市場）の推移



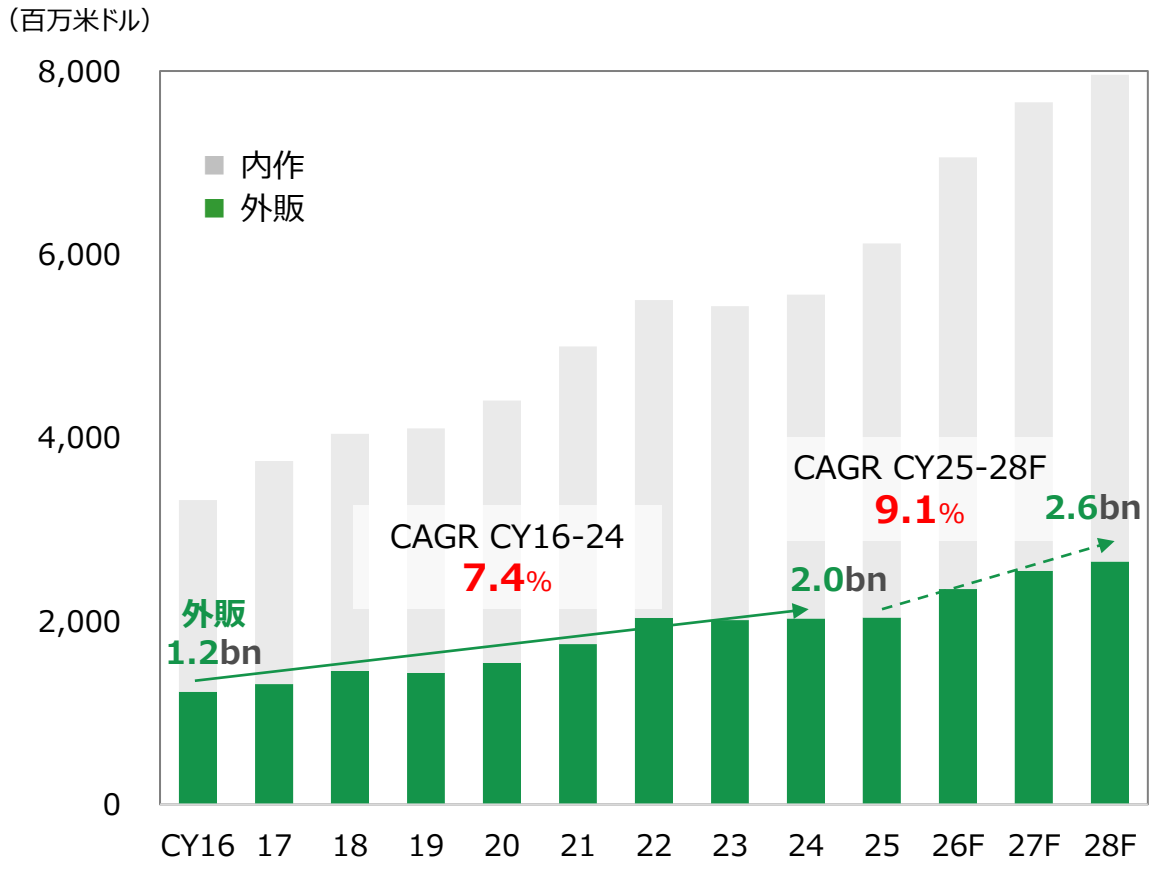
出典：当社推定

©Tekscend Photomask

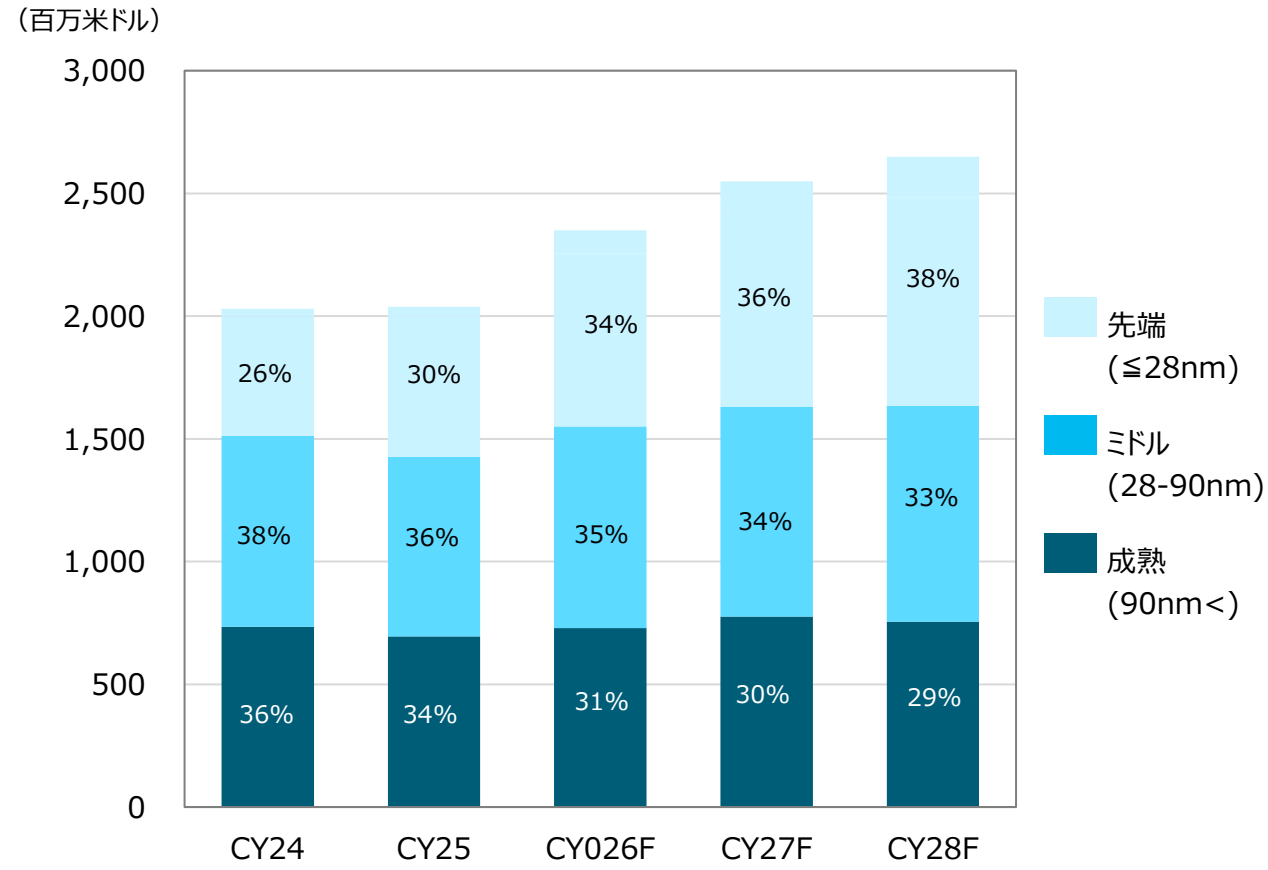
市場環境（フォトマスク）

- AI関連需要に加え、自動車や通信インフラ向け半導体の高機能化が半導体市場全体の成長を牽引しており、フォトマスク需要の拡大が見込まれる
- こうした市場環境を背景に、外販フォトマスク市場は年平均成長率9.1%で成長すると予測される
- 外販フォトマスク市場をノード別にみると先端向け中心に成長する見込み

フォトマスク市場の推移



ノード別外販フォトマスク市場の推移

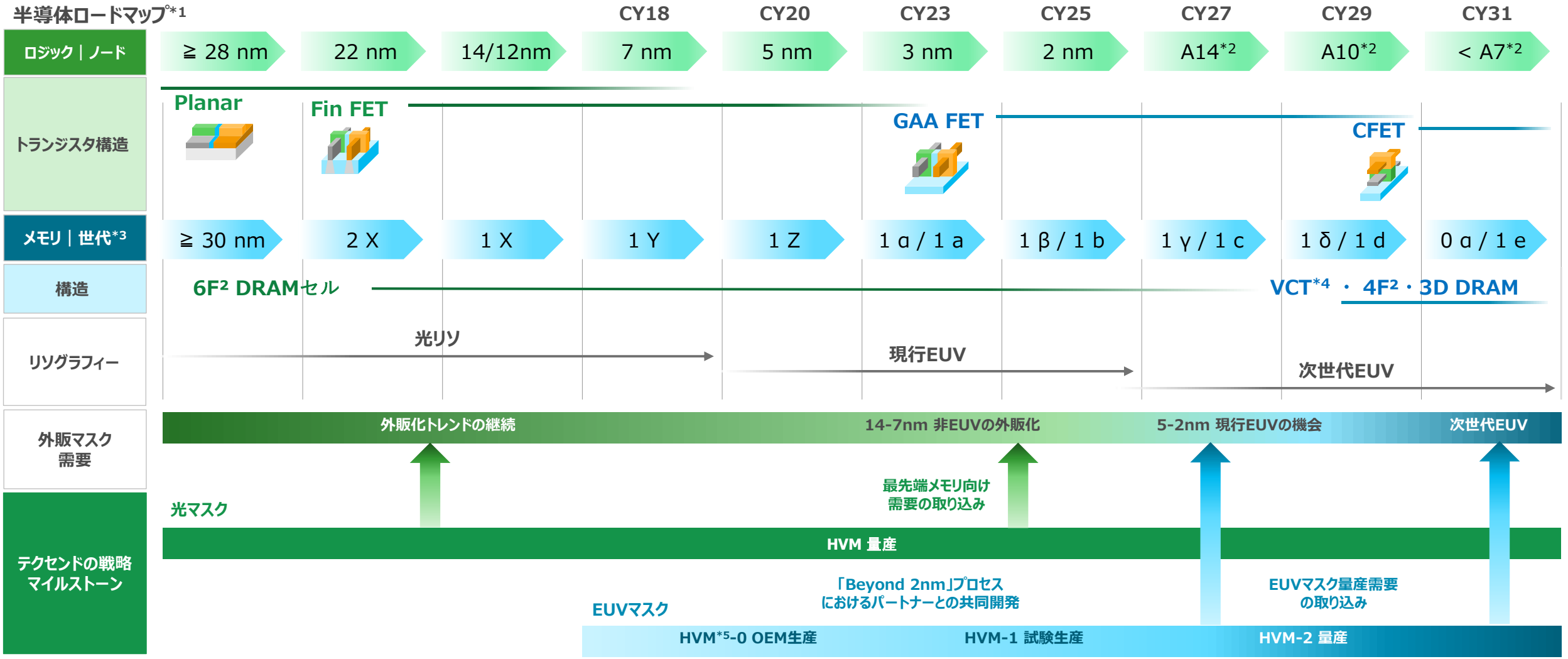


出典：SEMI+当社推定

©Tekscend Photomask

EUVビジネスの拡大

- Fin FET / EUVへのシフトに伴い、特に最先端領域におけるフォトマスクの外販化が加速
- 半導体業界のプロセスロードマップに合わせ、当社はEUVマスクの開発・量産体制構築を段階的に推進



注：
*1：ロジックはimecのスケーリングロードマップとTPCの予測に基づいて作成
*2：A14=1.4nm、A10=1.0nm、A7=0.7nm
*3：メモリは代表的DRAM世代。各社呼称・量産時期に違いあり
*4：VCT = Vertical Channel Transistor
*5：HVM = High Volume Manufacturing 大量生産

1stマスクベンダーとしての主な強み

1st Mask Vendor

1. 強固な顧客基盤
2. 成熟から先端までの幅広いノードカバー
3. グローバル生産体制
4. リーディングパートナーとの共同開発
5. EUVビジネスの拡大

Appendix

決算補足資料　損益計算書 (Non-GAAP)

(百万円)	2026年3月期				2027年3月期		2026年3月期
	第1四半期 4-6月	第2四半期 7-9月	第3四半期 10-12月	第4四半期 1-3月	第1四半期 4-6月	第2四半期 7-9月	通期
売上収益	30,076	31,695	34,462	33,341	**34,518**	**37,944**	129,576
売上総利益	9,811	11,088	10,749	11,619	**11,464**	**13,873**	43,269
売上総利益率	*32.6%*	*35.0%*	*31.2%*	*34.8%*	*33.2%*	*36.6%*	*33.4%*
調整後営業利益	5,981	7,208	7,104	8,111	**7,368**	**9,376**	28,407
調整後営業利益率	*19.9%*	*22.7%*	*20.6%*	*24.3%*	*21.3%*	*24.7%*	*21.9%*
調整後四半期利益	5,549	7,005	6,705	6,295	5,306	6,778	25,556
調整後親会社の所有者に帰属する四半期利益	5,549	7,005	6,705	6,295	**5,306**	**6,778**	25,556
EBITDA	*10,167*	*11,821*	*12,570*	*12,007*	*12,228*	*14,231*	*46,567*
EBITDAマージン	*33.8%*	*37.3%*	*36.5%*	*36.0%*	*35.4%*	*37.5%*	*35.9%*
調整後EBITDA	10,275	12,009	12,645	12,513	*12,237*	*14,269*	47,444
調整後EBITDAマージン	*34.2%*	*37.9%*	*36.7%*	*37.5%*	*35.5%*	*37.6%*	*36.6%*
為替レート (USD/JPY)	143.75	148.34	155.46	156.51	160.72	159.36	151.09

注：本資料には、EBITDA、EBITDAマージン、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後営業利益、調整後当期純利益等、一定の当社のIFRS非準拠の財務指標が含まれている。当該財務情報は日本基準またはIFRSに基づき作成されたものではなく、監査を受けたものでもない。

決算補足資料　損益計算書 (IFRS)

(百万円)	2026年3月期				2027年3月期		2026年3月期
	第1四半期 4-6月	第2四半期 7-9月	第3四半期 10-12月	第4四半期 1-3月	第1四半期 4-6月	第2四半期 7-9月	通期
売上収益	30,076	31,695	34,462	33,341	**34,518**	**37,944**	129,576
売上総利益	9,811	11,088	10,749	11,619	**11,464**	**13,873**	43,269
売上総利益率	*32.6%*	*35.0%*	*31.2%*	*34.8%*	*33.2%*	*36.6%*	*33.4%*
営業利益	5,875	7,020	7,028	7,605	**7,360**	**9,339**	27,530
営業利益率	*19.5%*	*22.2%*	*20.4%*	*22.8%*	*21.3%*	*24.6%*	*21.2%*
四半期利益	5,475	6,874	6,652	5,944	5,300	6,752	24,947
親会社の所有者に帰属する四半期利益	5,475	6,874	6,652	5,944	5,300	6,752	24,947
減価償却費	4,167	4,666	5,389	4,263	**4,725**	**4,749**	18,486
減価償却費率	13.9%	14.7%	15.6%	12.8%	**13.7%**	**12.5%**	14.3%
為替レート (USD/JPY)	143.75	148.34	155.46	156.51	160.72	159.36	151.09

決算補足資料　貸借対照表 (IFRS)

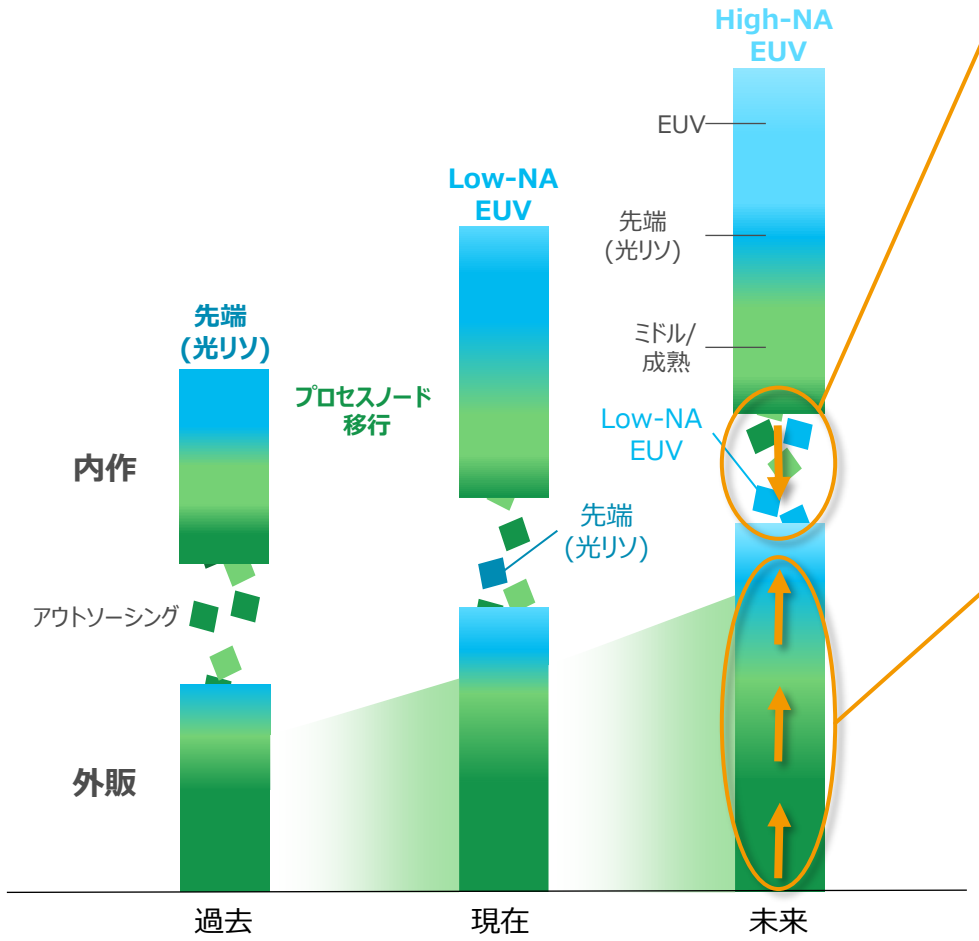
(百万円)	2026年3月末	2026年9月末
資産合計	**230,725**	**282,773**
現金及び現金同等物	51,552	91,537
営業債権及びその他の債権	32,610	33,396
その他の金融資産	12,520	11,030
棚卸資産	4,807	4,913
有形固定資産	109,074	120,076
持分法で会計処理されている投資	8,958	8,953
繰延税金資産	2,199	3,211
その他の資産	9,003	9,653
負債合計	**56,218**	**104,482**
営業債務及びその他の債務	19,065	20,928
借入金	1,460	50,199
その他の金融負債	14,138	12,711
未払法人所得税等	4,645	3,622
退職給付に係る負債	3,374	3,565
契約負債	4,884	4,003
その他の負債	8,648	9,450
資本合計	**174,507**	**178,291**
負債及び資本合計	**230,725**	**282,773**

決算補足資料　キャッシュフロー計算書 (IFRS)

(百万円)	2026年3月期 上半期 4-9月	2027年3月期 上半期 4-9月
営業活動によるキャッシュ・フロー	**16,278**	**21,162**
税引前利益	15,429	16,884
減価償却費及び償却費	8,833	9,475
運転資本の増減	▲583	▲1,523
その他営業活動	▲5,207	▲4,361
デリバティブ資産・負債の増減	▲2,193	687
投資活動によるキャッシュ・フロー	**▲22,776**	**▲21,912**
資産の取得・売却	▲20,381	▲22,720
貸付金による収入・支出	▲2,299	821
その他投資活動	▲94	▲13
財務活動によるキャッシュ・フロー	**7,585**	**41,414**
株式の発行による収入	―	―
自己株式の取得による支出	―	―
配当金の支払額	―	▲5,556
その他財務活動	7,585	46,971
フリー・キャッシュ・フロー	**▲6,498**	**▲749**

財務ハイライトと分析 – 外販市場の成長メカニズム

- 2026年3月期後半より、AIブームによるメモリメーカーの内作リソース逼迫でアウトソーシングが増加傾向



新規需要 – 内作ベンダーからのアウトソーシングの加速

EUVアウトソーシングの機会

- 従来型のLow-NA※ EUVは、EUVの採用加速とHigh-NAへの移行によりアウトソーシングが進む見込み

先端ノードおよび成熟ノードにおけるアウトソーシングの加速

- 最先端ノードへの集中や設備投資の必要性から、先端ノードのアウトソーシングが増加
- 生産能力の制限により成熟ノードのアウトソーシングが加速

既存需要 – 外販フォトマスクを活用するチップベンダーからの需要拡大

既存顧客からの構造的な需要拡大

- 半導体市場の拡大
- 半導体工場 / 生産ラインの拡張
- チップ設計数の増加 / 多様化
- 微細化によるマスクシート / レイヤー数の増加とASPの上昇

Low-NA EUV：現在5~2nmの半導体を製造するのに使用されているEUVのプロセス
High-NA EUV：次世代の1nm台以下の半導体向けに開発中のEUVプロセス

注：
※ NA=Numerical Aperture、開口数

2027年3月期　業績予想

日本円（百万円）	2027年3月期 通期予想	前年対比
売上収益	140,100	108.1%
USDベース 売上収益成長率	**12.6%**	+1.7pt
営業利益	29,800	108.2%
営業利益率	**21.3%**	+0.2pt
税引前利益	31,200	93.3%
親会社の所有者に帰属する当期利益	23,700	95.0%
EBITDAマージン	**34.2%**	▲1.7pt
一株当たりの配当	70.00円	+14.00円
想定為替レート（USD/JPY）	145.00円	▲6.09円

市場トレンド

外販フォトマスク市場の拡大

設計点数の増加に伴う必要マスク数の増加

先端比率上昇によるマージンの拡大

コスト管理

先端品生産キャパシティ拡大

レガシー設備延命及び更新投資の抑制

適切な費用管理による販管費率の低減

自動化・AI活用による人財配置の効率化

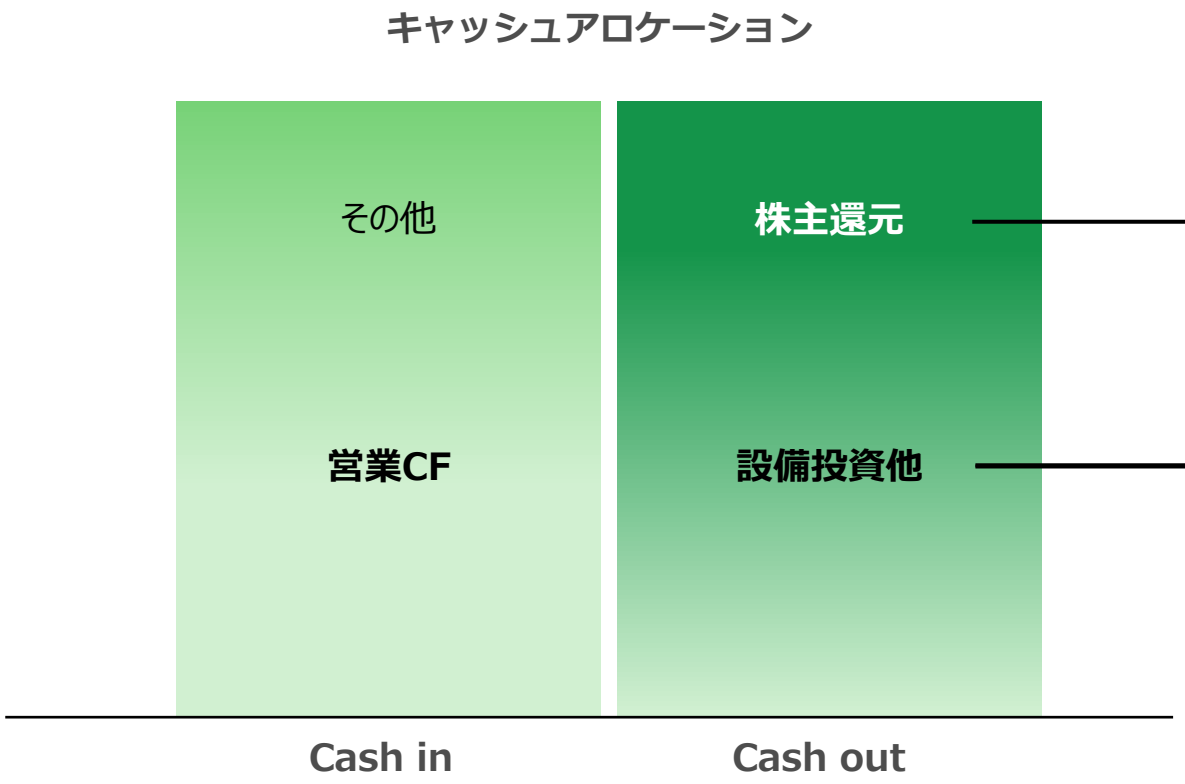
ERP更新による経費の増加

その他収益

金融収益（通貨スワップ評価益）の減

キャッシュアロケーション

- キャッシュイン：営業キャッシュフロー＋外部からの負債性調達（借入等）
- キャッシュアウト：株主還元（配当性向約30%）＋設備投資他



株主還元の内容

配当性向 約30%他

今後の主な設備投資の内訳

1) シンガポール新工場
・・・2027年前半　生産開始

2) 米国　ラウンドロック工場　先端
・・・2027年後半　生産開始

3) 韓国　利川工場　先端
・・・2028年後半　生産開始

4) EUV関連
・・・2027年　量産対応開始

免責事項

本資料は、テクセンドフォトマスク株式会社（以下「当社」といいます。）の企業情報等の提供のために作成されたものであり、米国、日本国又はそれ以外の一切の法域における有価証券への投資に関する勧誘を構成するものではありません。米国、日本国又はそれ以外の一切の法域において、適用法令に基づく登録若しくは届出又はこれらの免除を受けずに、当社の有価証券の募集又は販売を行うことはできません。
本資料の作成にあたり、当社は当社が入手可能なあらゆる情報の真実性、正確性及び完全性に依拠し、前提としていますが、その真実性、正確性又は完全性について、当社は何ら表明及び保証するものではありません。本資料に記載された情報は、事前に通知することなく変更されることがあります。本資料及びその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、第三者が、その他の目的で公開又は利用することはできません。本資料には、当社に関する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述がなされています。これらの記述には、「予想」、「予測」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」というような表現や将来の事業活動、業績、出来事又は状況を説明するその他の類似した表現が含まれることがありますが、これらに限られるものではありません。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報を基に、本資料の作成時点における当社の経営陣の判断に基づいて記載したものであり、また、一定の前提（仮定）の下になされています。そのため、これらの将来に関する記述又は前提（仮定）は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の結果はこれと大幅に異なる可能性があります。したがって、これらの将来に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。なお、本資料に記載された情報は本資料の日付（又はそこに別途明記された日付）時点のものであり、新たな情報、将来の出来事やその他の発見に照らして、将来に関する記述を変更又は訂正する一切の義務を当社は負いません。
当社の現在の決算期は3月末であります。また、本資料に含まれる全ての財務情報は、別途記載のない限り、連結ベースであり、国際会計基準（以下「IFRS」といいます。）に準拠しています。
本資料には、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後営業利益、調整後当期純利益等、一定の当社のIFRS非準拠の財務指標が含まれています。当該財務情報は日本基準またはIFRSに基づき作成されたものではなく、監査を受けたものでもありません。
本資料は、当社の企業情報等のご案内のみを目的として提供しています。本資料の複製は禁じられており、いかなる目的において又は方法によっても、他者に転送又は再配布してはなりません。本資料を提供するにあたり、当社は、追加情報へのアクセス手段、本資料の情報の更新、本資料に記載されている情報が不正確であることが明らかとなった場合の修正につき、一切責任を負いません。
当社は本資料の情報の利用により生じたいかなる損害に関し、一切責任を負うものではありません。
また、本資料に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等に関する情報は、公開情報又は第三者が作成したデータ等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について、当社は独自の検証を行っておらず、また、これを保証するものではありません。



TEKSCEND PHOTOMASK

https://www.photomask.com